FLYER

IT14 Series

0.9mmピッチ / 5mmスタッキングハイト

Mirror Mezz / 高速伝送対応、低背、BGAメザニンコネクタ

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

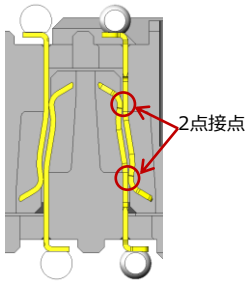
High-Speed　Low Profile　Stacking

特長

1. MOLEX社「Mirror Mezz」正式セカンドソース
2. 高速伝送対応（56+Gbps NRZ / 112+Gbps PAM4対応）
3. OAM標準接続コネクタ
4. 多芯高密度設計：688芯（cm²スペース当たり26差動ペア実装）
5. 雌雄同体設計
6. スタブレス2点接点構造
7. 端子先端をハウジングで保護し、嵌合時の座屈を防止

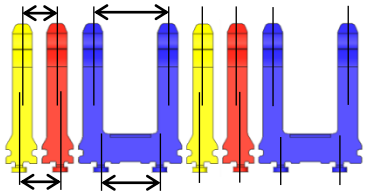
端子構造

スタブレス構造



・優れたSI性能
・2点接点構造で信頼性向上
・ワイピング量：最大1.5mm

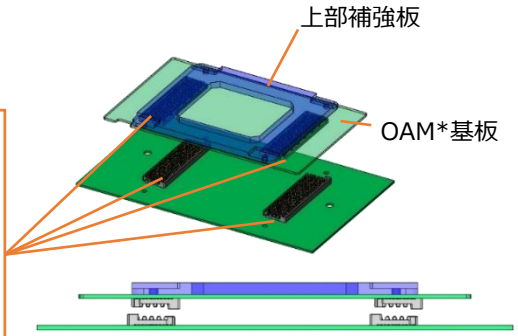
インピーダンスマッチング
（92Ωターゲット）



接触部と実装部のピッチを変え、
インピーダンスを最適化

OAM（OCPアクセラレータモジュール）に採用

IT14:
5mmスタッキングハイト
（2.5mm + 2.5mm）
688芯
172差動ペア



仕様

定格電流	1.2A
定格電圧	30V AC/DC
使用温度範囲	-55 ～ +105℃
接触抵抗*	30mΩ 以下
耐電圧	500V DCで1分間
絶縁抵抗	1000MΩ（500V DC）
挿抜回数	100回
インピーダンス	92Ω

*導体抵抗を含む。

-MOLEX社「Mirror Mezz」とクロス嵌合可能。
-芯数：688芯

*OAM＝OCP（Open Computer Project）アクセラレータモジュール

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

MKT-J-20051F_1 Issued: Nov. 22, 2021 © 2021 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved. 予告なく、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。